

## AMPMODU | AMPMODU Headers

TE 内部编号 1-966573-4

PCB Mount Header, Vertical, Board-to-Board, 14 Position, 2.54 mm

[.1 in] Centerline, Breakaway, Tin, Through Hole - Solder, Signal,

AMPMODU Headers

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 &gt; PCB 连接器 &gt; PCB 板端连接器及母端



连接器系统: 板对板

位数: 14

行数: 1

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

PCB 安装方向: 垂直

## 产品特性

### 产品类型特性

|             |          |
|-------------|----------|
| 连接器系统       | 板对板      |
| 接头类型        | 分离       |
| 可密封         | 否        |
| 连接器和端子端接到   | 印刷电路板    |
| PCB 连接器组件类型 | PCB 安装接头 |

### 结构特性

|           |    |
|-----------|----|
| 板对板配置     | 平行 |
| 连接器端子负载状态 | 满载 |
| 位数        | 14 |
| 行数        | 1  |
| PCB 安装方向  | 垂直 |

### 主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 绿色 |
|--------|----|

### 接触件特性

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| PCB 端子端接区域电镀材料厚度 | 2 $\mu$ m                 |
| 端子接合区域电镀材料厚度     | 2 $\mu$ m[78.74 $\mu$ in] |
| 端子形状和构造          | 正方形                       |
| 端子底板材料           | 镍                         |



|                |     |
|----------------|-----|
| PCB 端子端接区域电镀材料 | 锡   |
| 端子基材           | 磷青铜 |
| 端子接触部电镀材料      | 锡   |
| 端子类型           | 插针  |
| 端子额定电流 (最大值)   | 3 A |

### 端接特性

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 端接柱体和尾部长度的长度 | 3.2 mm[.126 in] |
| PCB 端接方法     | 通孔 - 焊接         |

### 机械附件

|            |           |
|------------|-----------|
| PCB 安装固定类型 | 作用/符合标准的尾 |
| 连接器安装类型    | 板安装       |
| 接合对准       | 不带        |
| PCB 安装对准   | 不带        |
| PCB 安装固定   | 带有        |

### 壳体特性

|          |                |
|----------|----------------|
| 外壳材料     | 聚酯-GF          |
| 中心线 (间距) | 2.54 mm[.1 in] |

### 尺寸

|             |                  |
|-------------|------------------|
| PCB 厚度 (建议) | 1.57 mm[.062 in] |
|-------------|------------------|

### 使用环境

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 壳体温度额定值 | 标准                         |
| 工作温度范围  | -65 – 105 °C[-85 – 221 °F] |

### 操作/应用

|        |        |
|--------|--------|
| 焊接工艺特性 | 板支座    |
| 电路应用   | Signal |

### 行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

### 包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | Box |
|------|-----|

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



|  |   |
|--|---|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU   | 符合  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC  | 符合  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令) | 没有超出阈值的受限材料   |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                                | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量   | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °   |
| 焊接工艺能力   | 不适合采用焊接工艺   |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



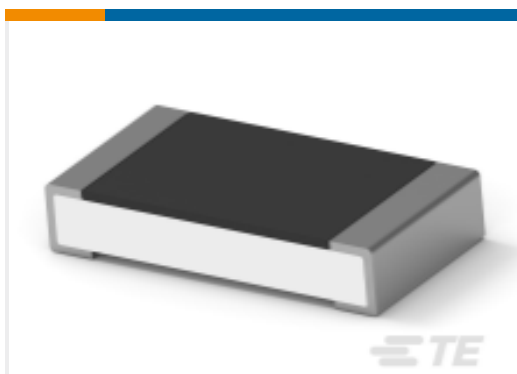
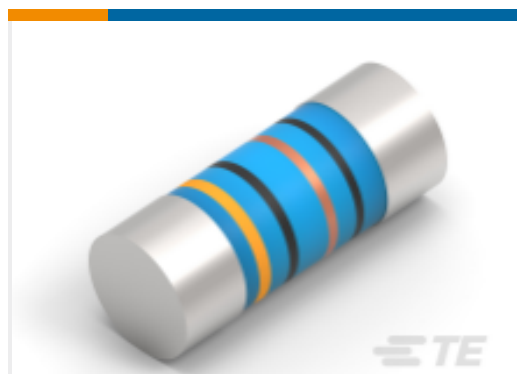
该系列中的其他产品 | AMPMODU Headers





连接器端子(64)

## 客户还购买了

TE 产品编号1-1825006-9  
GDS10S04=DIP SW,SLIDE,SMTTE 产品编号1-928836-2  
MOD2 PIN WITH A-PIN L/PTE 产品编号7-2176246-6  
CRGS2512 5% 1M8TE 产品编号3-1415020-1  
PT570N20TE 产品编号4-2176391-7  
RQ 1206 37K4 0.1% 10PPM 5K RLTE 产品编号2176314-4  
MELF SMA\_A 180R 0.1% 15PPM 0102  
0.3WTE 产品编号1-1437581-1  
ASE22RL=AUTOSLIDE DP  
0.3W

## 文档

### 产品图纸

14P MOD2 ST-LEI A-P

英文版本

### CAD 文件

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_1-966573-4\\_A2.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_1-966573-4\\_A2.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_1-966573-4\\_A2.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

### 3D PDF

英文版本



---

**数据表/目录页**

[AMPMODU Interconnection System](#)

[AMPMODU Interconnection System](#)

英文版本